



半導体・計測・カメラでAI社会を支える。

会社紹介

2026年8月28日



東証スタンダード 証券コード：6614



1. 当社の概要
2. 事業と強み
3. 業績動向
4. 成長戦略



1

当社の概要



国内8拠点

■ : 主拠点

□ : フロント拠点
(主にお客様対応)

DC : デザインセンター



社名

株式会社シキノハイテック

所在地

富山県魚津市：本社拠点
国内8拠点

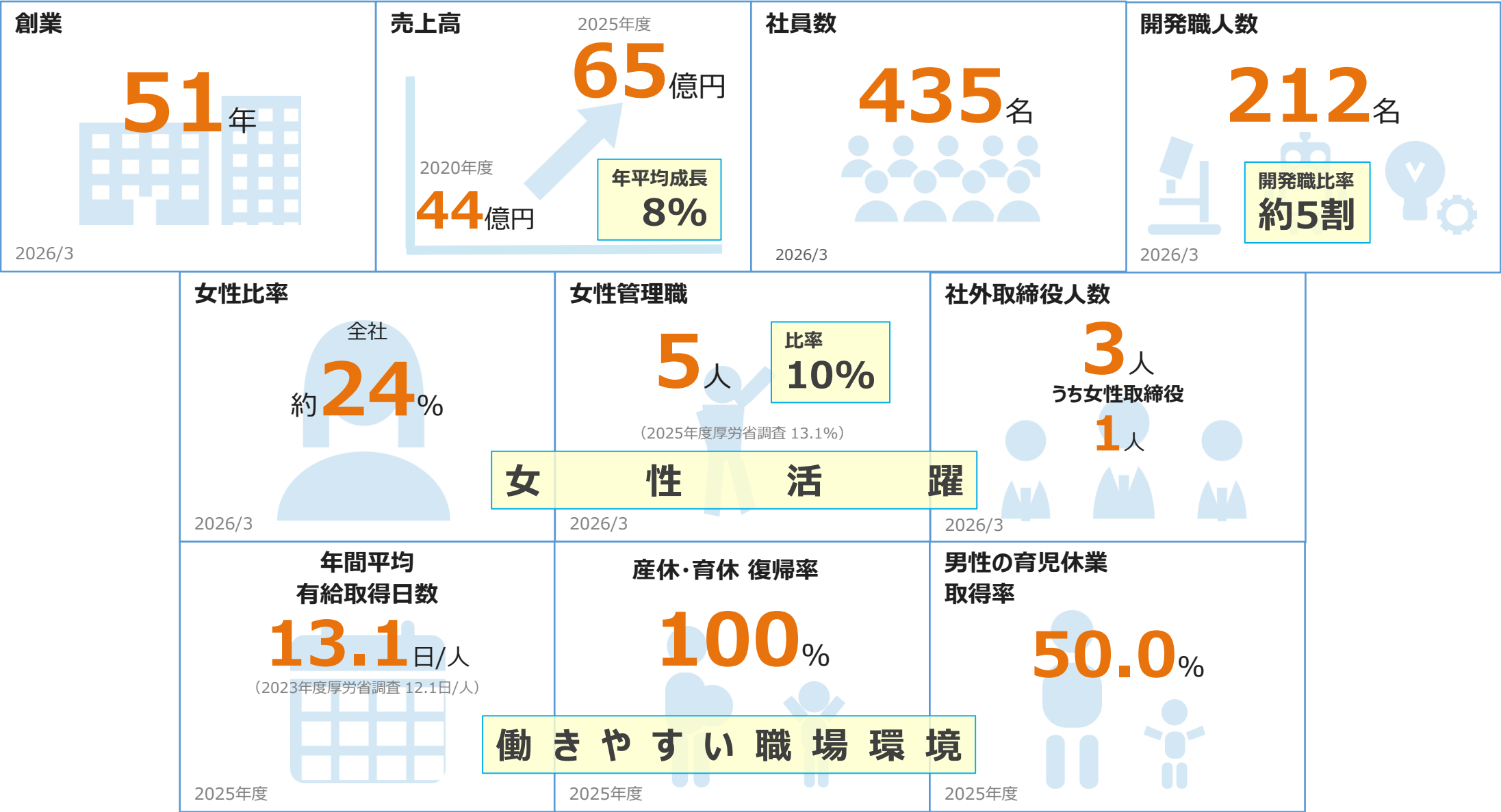
上場市場

スタンダード市場
証券コード：6614

事業内容

分野 ・半導体
・ソリューション

事業 ・電子システム
・マイクロエレクトロニクス
・製品開発



女性活躍

働きやすい職場環境

※青太文字は日本企業

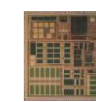
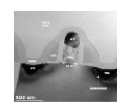
前工程

後工程

回路設計

半導体ウェハに回路形成

テスト パッケージング



垂直統合型半導体メーカー

プロセッサ&マイコン	メモリー	アナログ・パワー	イメージセンサー
インテル、 ルネサス 、STマイクロ、NXP	サムスン、SK、マイクロン、 キオクシア	TI、インフィニオン、 東芝 、 ローム 、富士電機、デンソー	ソニー 、オムニビジョン、etc

水平分業型半導体メーカー

ファブレス半導体メーカー	ファウンドリー	OSAT
Apple、Qualcomm、NVIDIA、AMD、Broadcom、Mediatek、 ソシオネクスト	TSMC、UMC、Global Foundry、SMIC、Tower、 TPSCo 、etc	ASE、Amkor、etc

回路ブロック開発（IPベンダー）

ARM、Synopsys、Cadence

シキノハイテック

スマホ・宇宙・AI

回路ブロック設計（受託開発・人材派遣）

TOPPANテクニカル・デザインセンター、NSW メイテック

シキノハイテック

センサー・車載・IoT

設計用システム（EDAベンダー）

Synopsys、Cadence、Siemens、**JEDAT**

製造装置

Applied Materials、ASML、Lam Research、**東京エレクトロン**、KLA、**SCREEN**、**キヤノン**、**Nikon**、国際電気、レーザーテック

材料

信越化学、SUMCO、東京応化、富士フイルム、**TOPPAN**、大日本印刷

製造装置

ディスコ、東京精密

検査装置

アドバンテスト、Teradyne

シキノハイテック

AI・車載

材料

京セラ、新光電気

セルフサービス

KIOSK端末
受付端末



POSセルフレジ



券売機/精算機



検査・分析機器



医療用検査
分析装置



計量機



食品機械
各種製造機器



見守りカメラ



社会インフラ・産業（FA）

自動搬送車



セキュリティ
ゲート



コード認識
カードリーダー



顔認証装置



車番認識



モーター
分析器



Nessum
通信

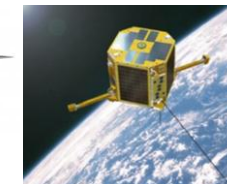


防衛・宇宙

ドローン



人工衛星



船舶



各ソリューション分野に最適な計測装置やカメラモジュールを提供

自社商品



2

事業と強み

電子システム・マイクロエレクトロニクス・製品開発の3本部で事業を展開

マイクロエレクトロニクス事業

- 半導体設計（アナログ・デジタル）
~6nm
- IPコア（回路ブロック：画像処理）



- 半導体信頼性試験装置

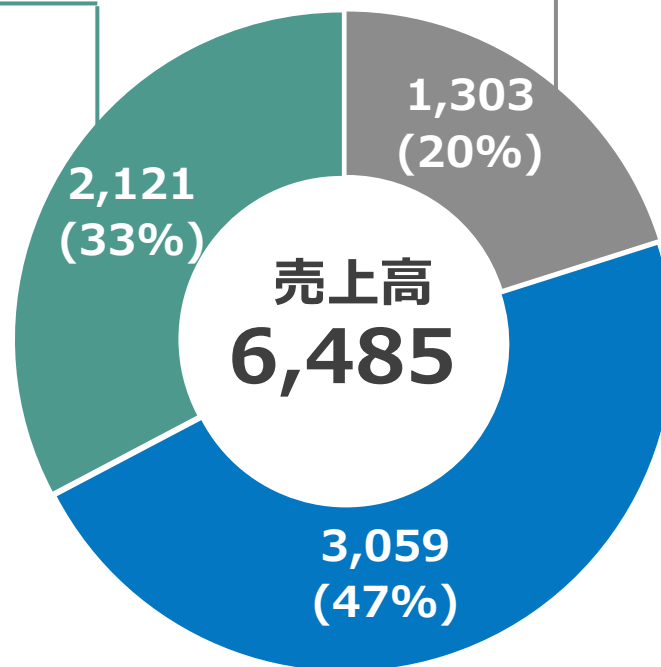
重量2.3t

高さ2.4m



【2026/3月期売上構成】

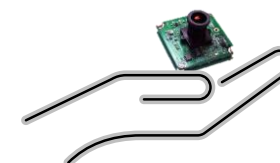
(単位：百万円)



電子システム事業

製品開発事業

- 組込カメラモジュール



数cm角

- 画像システム



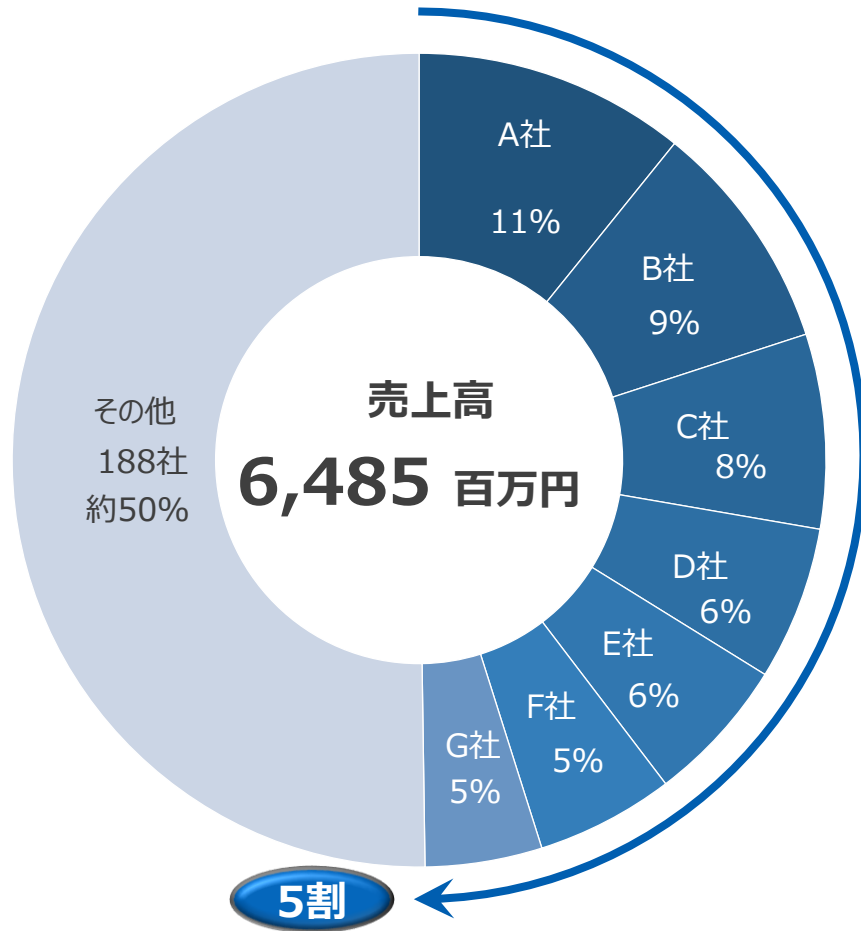
幅10cm

- カスタム計測器



幅15cm

【 2026/3月期】



国内を中心に AI、センサ、車載、防衛、産業を支える

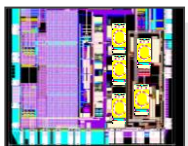
- ・ 主要半導体メーカー
- ・ 航空宇宙防衛産業メーカー
- ・ 車載Tier1メーカー

など安定した顧客基盤を持つ

各事業を支える5つのコア技術と国内一貫生産を強みとする

① 半導体設計

多数のアナログ
設計技術者



画像処理技術



② カメラ

画像デジタル処理
画像センシング



レンズ、センサ
基板までを
最適モジュール化



③ 計測・制御

高精度計測・制御
を実現



電力線通信
によるシステム
最適化



④ 装置化

回路・基板・筐体・
ソフトを統合、
小～大型の装置
として具現化



⑤ 信頼性評価

半導体やモジュール
信頼性評価技術



国内一貫生産体制

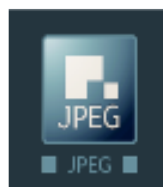
設計から製造・品質保証まで自社で対応



スマホ向けJPEG IP

世界シェア

20%



(当社調べ)

マイクロエレクトロニクス

車載向け半導体
信頼性試験装置

国内シェア

1位



(当社調べ)

電子システム

産業用 組込カメラ

国内シェア

1位



(当社調べ)

製品開発

各セグメント・技術の強みを掛け合わせる事で顧客課題の解決提案を加速

【半導体設計】 × 【カメラ】

AI向け画像処理回路を搭載した
カメラモジュール



【カメラ】 × 【装置化】

カメラとセンサを組み合わせた
介護見守りシステム



介護・見守りに必要な機能オールインワン！



【計測・制御】 × 【信頼性評価】 × 【装置化】

AI半導体を個別温度制御
信頼性を試験する装置



【計測・制御】 × 【装置化】

電流計測による
モーター劣化分析装置



【カメラ】 × 【計測・制御】

既設電力線を利用できる
カメラ





3

業績動向

売上高及び利益とも前期比で増収・増益

- 売上高は、電子システム事業で減収もマイクロエレクトロニクス事業及び製品開発事業で増収となり、全体としても微増
- 利益は、電子システム事業、マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業の3事業ともに増益

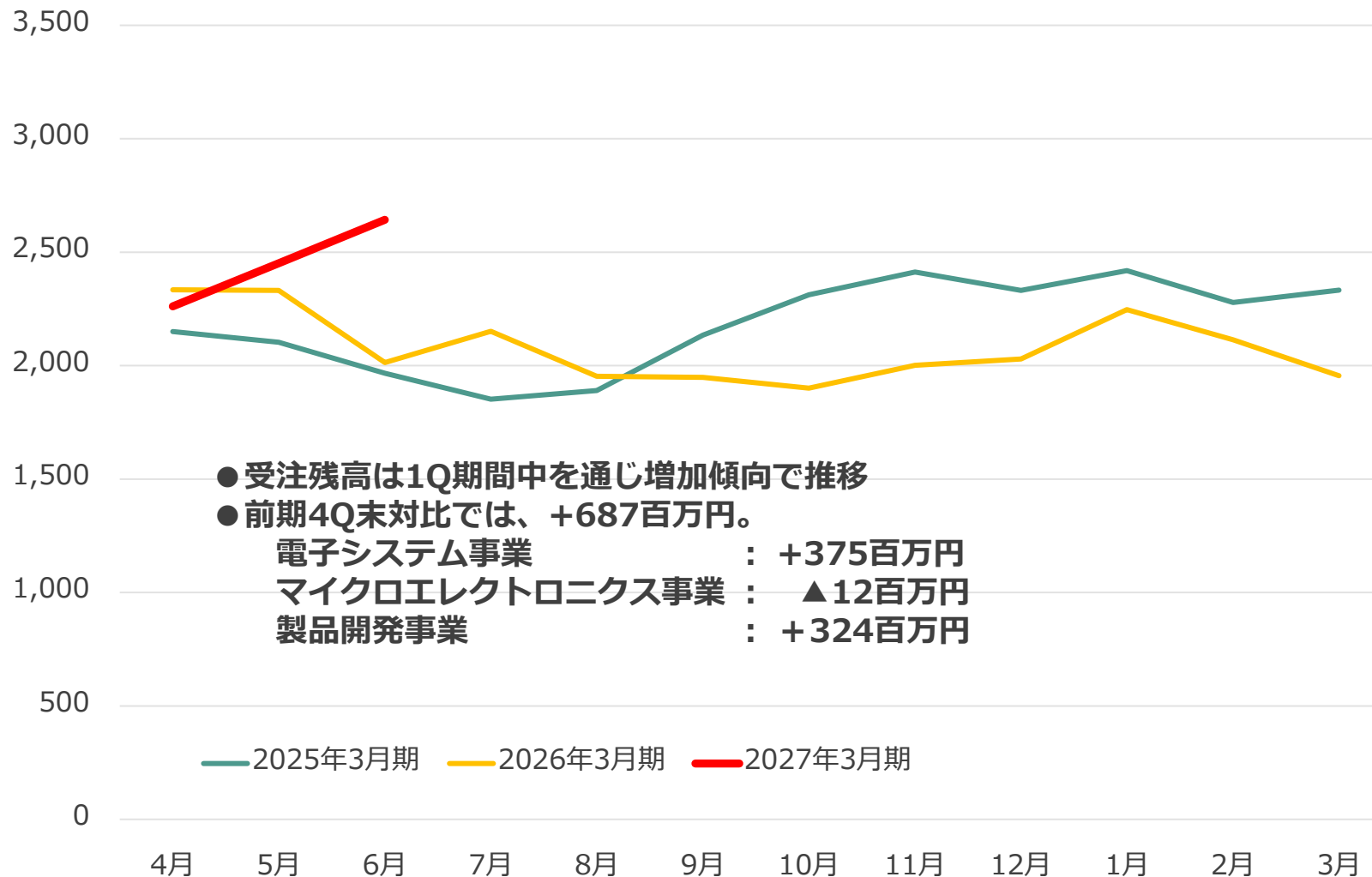
(百万円 ・ %)

	2027/3月期1Q実績	
	金額	構成比
売上高	1,535	100.0
販管費	294	19.2
営業利益	19	1.2
営業利益率	1.2	-
経常利益	21	1.4
当期純利益	21	1.4

2026/3月期1Q 実績		対前期
金額	構成比	差
1,519	100.0	16
310	20.4	▲16
▲106	▲7.0	125
▲7.0	-	-
▲105	▲7.0	127
▲75	▲5.0	96

【受注残高（全社）】

（単位：百万円）



2027年3月期は増収増益を予想

- 電子システム事業は減収、マイクロエレクトロニクス事業及び製品開発事業は増収、全体として増収を見込む
- 製品開発事業については、KIOSK端末の新規獲得および防衛分野商材や海外ATMが好調
- 利益については商品構成変化による利幅増加と増収による利益増加により増益を見込む

【全社】

(単位：百万円)	2026/3月期 通期実績	2027/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,485	6,709	223	3.4%
営業利益	△169	117	286	-
経常利益	△165	107	273	-
当期純利益	△109	82	191	-
研究開発費	160	220	60	37.7%

【セグメント別】

(単位：百万円)	2026/3月期 通期実績	2027/3月期 通期予想	増減額	増減率
売上高	6,485	6,709	223	3.4%
電子システム事業	3,059	2,962	△97	△3.2%
マイクロエレクトロニクス事業	2,121	2,234	112	5.3%
製品開発事業	1,303	1,512	210	16.0%



4

成長戦略

3つの事業セグメントの技術・ノウハウを活かし、ソリューションとして成長領域に価値を提供

2021年3月
IPO

2025年度
各事業で成長

各事業コア技術・ノウハウ融合

売上高
100億円

経常利益
10億円

2030年

売上高
65億円

売上高
44億円

コア技術



提供ソリューション

ビジョン（見る）
&
センシング（測る）

半導体評価
&
半導体設計

成長領域

産業・医療

社会インフラ
（介護含む）

防衛・宇宙

AI・データセンター
（光電融合含む）

2021年3月期

2026年3月期

強みのコア技術の進化と収益力強化

強みを磨き、稼ぐ力を高める

成長領域への注力で事業拡大

次の成長の柱を育てる

グローバル連携による事業機会の拡大

パートナーとの協業で、新たな市場を拓く

経営基盤の変革と人材力向上

人とデータの力で、変革を加速する

4つの成長領域に注力、社会・産業の変化を捉え、当社コア技術で成長機会を取り込む

産業・医療

省人化・自動化
医療検査の高精度化

CAGR

約**10%**

社会インフラ

省人化・自動化
設備更新・スマートインフラ
高齢化

約**12%**

防衛・宇宙

安全保障環境の変化
防衛力強化・衛星活用

約**8%**

AI・データセンター

AI普及・計算需要増
半導体高性能化・省電力化

約**14%**

約**30%**

当社事業領域ベース

シリコンフォトニクス市場

カスタム小型カメラ
Edge-AIカメラ

劣化診断装置、カメラ
見守り機器

カスタム検査装置、カメラ
低遅延圧縮IP

高出力・光半導体
評価装置

半導体設計（センサ・画像・高速インターフェース）



：各成長領域に関する代表市場の世界市場CAGR（2025－2030）

出典:MarketsandMarkets, Grand View Research, The Business Research Company 各市場調査を参考に当社対象領域へ補正

半導体検査



台湾市場展開強化

半導体IP



戦略的提携・ポートフォリオ強化

通信システム



電力線通信技術・製品力強化
ライセンス

カメラソリューション



カメラ事業領域拡張

カメラモジュール



欧州市場展開強化

R&D・設備投資



コア技術・成長領域への重点投資

- ソリューションラインナップ拡大
- 競争力ある製品・技術の開発
- 生産能力・開発基盤の強化

人的資本の最大化



人が主役の経営へ

- 教育・研修制度の充実
- 役割主義に基づく人事制度改革
- 成長を支える人材の採用・育成

AI投資



データを活かす経営へ

- 基幹システムのデータ活用拡大
- 業務プロセスのデジタル、AI化
- 生産工程のスマート化

受託で培ったコア技術を基にソリューションへと展開、進化を進めています

売上

100億円以上

ROE

15%以上

経常利益

10億円以上

安定配当：株主資本配当率

3%以上

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っており、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・ 表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・ 比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役

執行役員管理本部長 舩田 敏彰

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>